

請求の範囲

- [請求項1] 湿式還元法によって第1液媒中に銅粒子を生成させて、該銅粒子の分散体を調製し、然る後に、
前記分散体の湿潤状態を維持しながら、該分散体の第1液媒を最終的に第2液媒に置換して、前記銅粒子と第2液媒とを含む接合用組成物を得る、接合用組成物の製造方法。
- [請求項2] 液媒の置換を100℃未満で行う、請求項1に記載の製造方法。
- [請求項3] 第2液媒として、水、アルコール、ケトン、エステル、エーテル及び炭化水素のうち一種以上を用いる、請求項1又は2に記載の製造方法。
- [請求項4] 前記銅粒子は、走査型電子顕微鏡によって測定された累積体積50容量%における体積累積粒径 D_{SEM50} が100nm以上300nm以下である、請求項1～3のいずれか一項に記載の製造方法。
- [請求項5] 第1液媒を他の液媒に一回以上置換し、最終の置換に第2液媒を用いる、請求項1～4のいずれか一項に組成物の製造方法。
- [請求項6] 前記分散体の湿潤状態を維持しながら、第1液媒を他の液媒に置換する、請求項5に記載の製造方法。
- [請求項7] 有機高分子の非存在下で行う、請求項1～6のいずれか一項に記載の製造方法。
- [請求項8] 請求項1～7のいずれか一項に記載の製造方法で得られた接合用組成物を含む導電性ペーストの製造方法。
- [請求項9] 請求項1～7のいずれか一項に記載の製造方法で得られた接合用組成物を2つの被接合材の間に配する、被接合材の接合方法。